

電子デバイス実装研究委員会および有機/無機接合研究委員会 合同オンライン研究委員会

(第 51 回電子デバイス実装研究委員会、第 23 回有機/無機接合研究委員会)

日時：2024 年 12 月 10 日 (火) 13:00~16:05

オンライン開催

プログラム

司会 小林 竜也 (群馬大学)

13:00~13:05 開会挨拶

有機/無機接合研究委員会 委員長 荘司 郁夫

13:05~13:45

『シート型センサの超柔軟化と非破壊計測手法への応用』(40 分)

..... ○荒木 徹平 (大阪大学)

13:45~14:25

『チューブと紐の二重構造からなる線状柔軟グリッパの動作原理の開発』(40 分)

..... ○LONG ZEYU、若松 栄史、岩田 剛治 (大阪大学)

14:25~14:40 休憩

司会 巽 裕章 (大阪大学)

14:40~15:20

『エポキシ接着剤の接着力に影響するアルミニウム表面因子の評価』(40 分)

..... ○岩井 美奈, 光岡 拓哉, 安孫子 勝寿 ((株)豊田中央研究所)

15:20~16:00

『AgSn 液相拡散接合材料の開発』(40 分)

..... ○岸本 貴臣、竹内 順一
(田中貴金属工業(株))

16:00~16:05 閉会挨拶

電子デバイス実装研究委員会 委員長 久田 隆史

() 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会